

ADHESIVE PEEL AND STICK HEAT SINKS



- With pre-applied adhesive, just peel off the release liner and press onto the component
- Reduces assembly costs; no more messy adhesives or greases required
- Excellent mechanical bond
- Thermally optimized pin fin
- Omnidirectional
- Adhesive shear strength at 100°C is 36psi (a one inch square heat sink would require a 36lb. force to remove heat sink)
- Applicable for BGA, PGA, PLCC, and QFP packages



| PART NUMBER*** | SIZE | | | | PIN FIN CONFIGURATION | | | THERMAL RESISTANCE CASE TO AMBIENT* °C/WATTS | |
|----------------|------|------|------|-----|-----------------------|------|------------|--|------------------------------|
| | (W) | (L) | (H) | T | P | G | FIN MATRIX | NATURAL CONVECTION** | FORCED CONVECTION @ 400 LFPM |
| BDN09-3CB/A01 | 0.91 | 0.91 | .355 | .09 | .069 | .072 | 7x7 | 26.9 | 9.6 |
| BDN09-6CB/A01 | | | .605 | .10 | .132 | .128 | 4x4 | 24.5 | 7.7 |
| BDN10-3CB/A01 | 1.01 | 1.01 | .355 | .09 | .083 | .072 | 7x7 | 26.4 | 8.0 |
| BDN10-5CB/A01 | | | .555 | .10 | .111 | .114 | 5x5 | 20.8 | 6.3 |
| BDN11-3CB/A01 | 1.11 | 1.11 | .355 | .09 | .076 | .072 | 8x8 | 20.9 | 7.2 |
| BDN11-6CB/A01 | | | .605 | .10 | .119 | .128 | 5x5 | 18.5 | 5.7 |
| BDN12-3CB/A01 | 1.21 | 1.21 | .355 | .09 | .060 | .081 | 9x9 | 19.6 | 6.8 |
| BDN12-5CB/A01 | | | .555 | .10 | .105 | .114 | 6x6 | 16.5 | 5.2 |
| BDN13-3CB/A01 | 1.31 | 1.31 | .355 | .09 | .074 | .081 | 9x9 | 16.1 | 6.0 |
| BDN13-5CB/A01 | | | .555 | .10 | .125 | .114 | 6x6 | 14.9 | 4.7 |
| BDN14-3CB/A01 | 1.41 | 1.41 | .355 | .09 | .067 | .081 | 10x10 | 16.2 | 5.6 |
| BDN14-6CB/A01 | | | .605 | .10 | .128 | .128 | 6x6 | 13.1 | 4.2 |
| BDN15-3CB/A01 | 1.51 | 1.51 | .355 | .09 | .062 | .081 | 11x11 | 15.1 | 4.5 |
| BDN15-5CB/A01 | | | .555 | .10 | .118 | .114 | 7x7 | 11.9 | 3.8 |
| BDN16-3CB/A01 | 1.61 | 1.61 | .355 | .09 | .072 | .081 | 11x11 | 13.5 | 4.5 |
| BDN16-6CB/A01 | | | .605 | .10 | .119 | .128 | 7x7 | 10.6 | 3.5 |
| BDN17-3CB/A01 | 1.71 | 1.71 | .355 | .09 | .065 | .072 | 13x13 | 11.5 | 3.8 |
| BDN18-3CB/A01 | 1.81 | 1.81 | .355 | .09 | .072 | .072 | 13x13 | 10.8 | 3.5 |
| BDN18-6CB/A01 | | | .605 | .10 | .128 | .114 | 8x8 | 8.1 | 2.8 |
| BDN19-3CB/A01 | 1.91 | 1.91 | .355 | .09 | .069 | .072 | 14x14 | 9.9 | 2.9 |
| BDN21-3CB/A01 | 2.11 | 2.11 | .355 | .09 | .064 | .072 | 16x16 | 8.5 | 2.6 |

NOTES:

*Thermal resistance of adhesive tape is included.

**Thermal resistance values based on power density of 3 watts/in²

***Part numbers listed for standard black anodized heat sinks with CTS adhesive tapes.

All dimensions are in inches.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9